

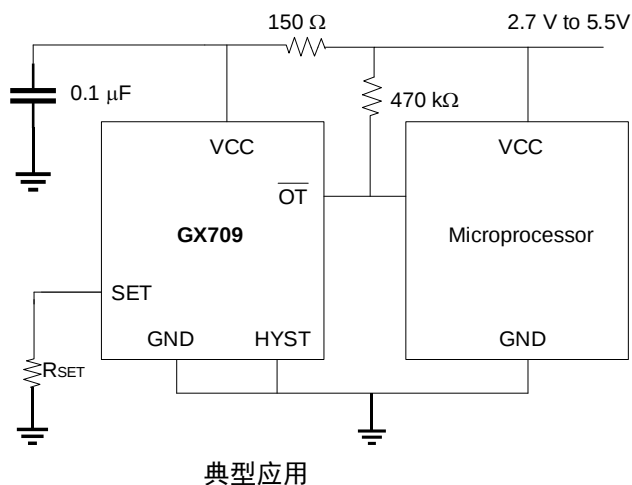
GX709 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装的可编程电阻器温度开关

1 特性

- 阈值精度：
 - 典型值 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
 - 最大值 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ($+60^{\circ}\text{C}$ 至 $+100^{\circ}\text{C}$ 时)
- 由1%外部电阻器设定的温度阈值
- 低静态电流：典型值为 $33\mu\text{A}$
- 开漏、低电平有效输出级
- 可通过引脚选择的 2°C 或者 10°C 温度滞后
- $V_{\text{CC}}=0.8\text{V}$ 上指定的复位操作
- 电源范围：2.7V至5.5V
- 封装方式：5引脚SOT23、6引脚DFN封装

2 应用范围

- 计算机（笔记本和台式机）
- 服务器
- 工业用和医疗用设备
- 存储区域网络
- 汽车电子



3 芯片概述

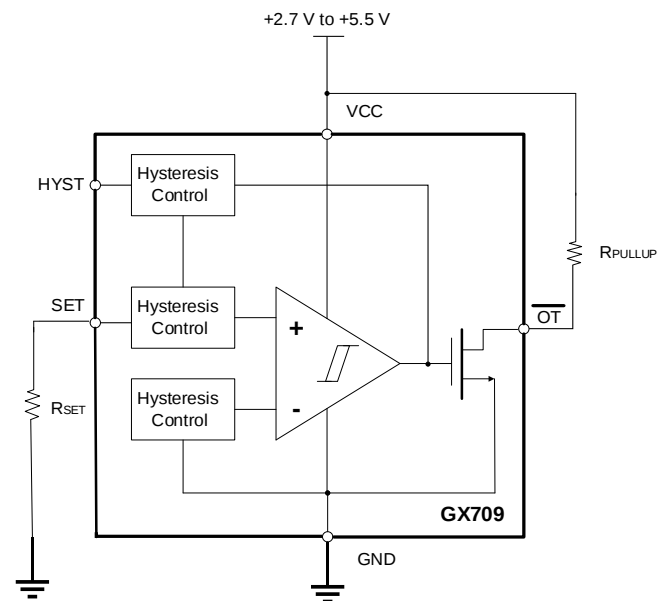
GX709是一款完全集成的、可编程电阻器温度开关，在其全工作范围内，只需一个外部电阻器即可设定温度阈值。GX709 提供一个开漏、低电平有效输出和一个介于2.7V至5.5V的电源电压范围。

温度阈值精度的典型值为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 而最大值为 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ($+60^{\circ}\text{C}$ 至 $+100^{\circ}\text{C}$ 时)。静态流耗的典型值为 $33\mu\text{A}$ 。可通过引脚选择来确定 2°C 或者 10°C 的温度滞后。

GX709采用5引脚SOT23和小尺寸DFN6L封装。

芯片封装信息

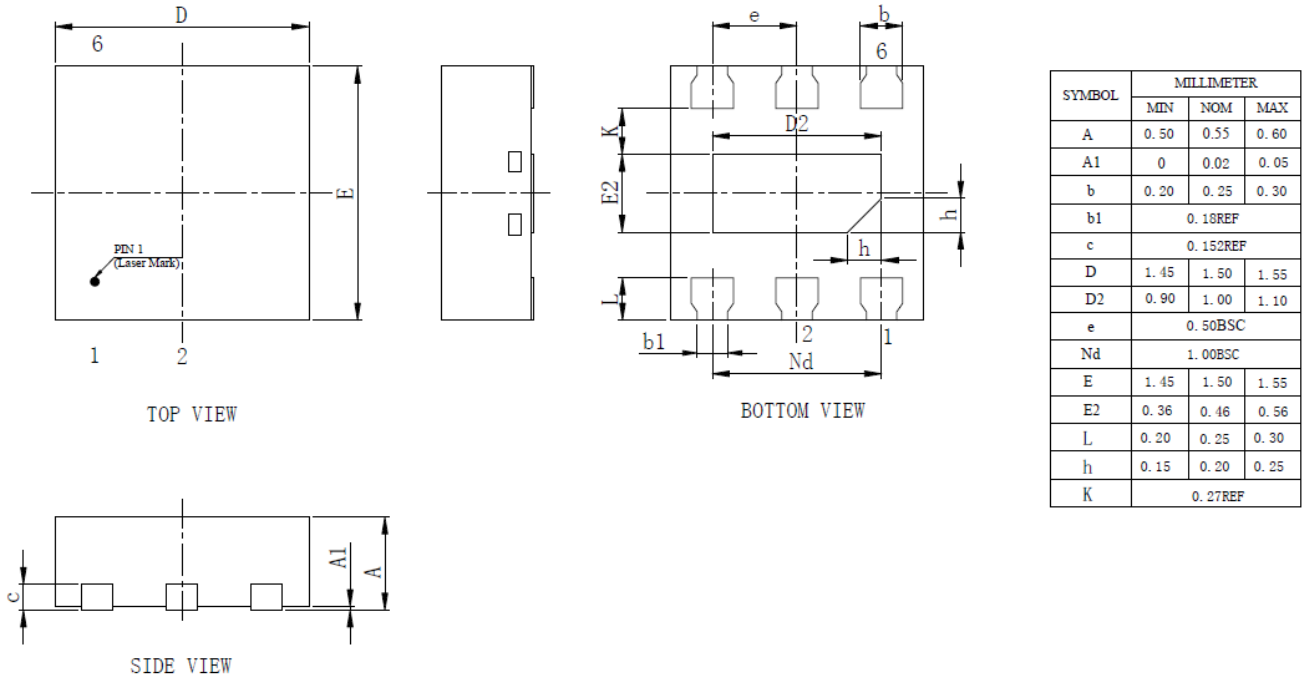
产品编号	封装信息	芯片封装面积(NOM)
GX709	裸片	0.919 mm × 0.579 mm
GX709S	SOT23-5	2.80 mm × 1.60 mm
GX709D	DFN6L	1.5 mm × 1.5 mm



芯片内部结构图

8 封装信息

DFN6L 芯片外形及 PCB 尺寸信息



9 订购信息

购买编码	器件	封装	标准包装数量	备注
GX709-T&R	GX709	Die	3000	裸片出货，卷带包装
GX709S-T&R	GX709	SOT23-5	3000	卷带包装
GX709D-T&R	GX709	DFN6L	4000	卷带包装